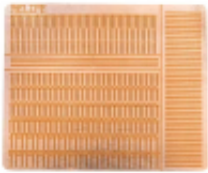


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rl-007ga-arkusz-padow-miedzianych-do-naprawy-sciezekrelife-p-14262.html>

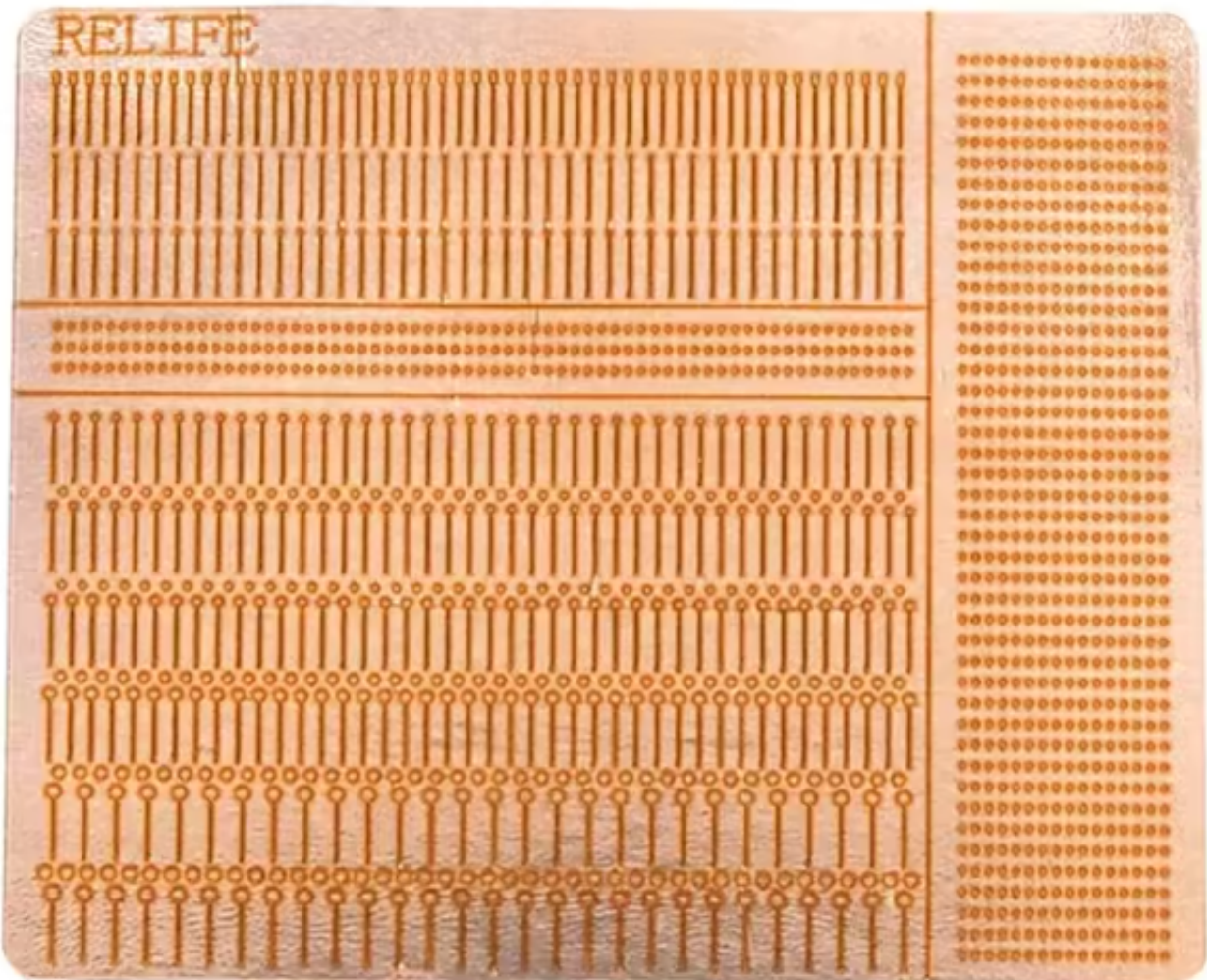


RL-007GA arkusz padów miedzianych do naprawy ścieżek RELIFE

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RL-007GA
Kod EAN	6949639109491
Producent	Relife

Opis produktu

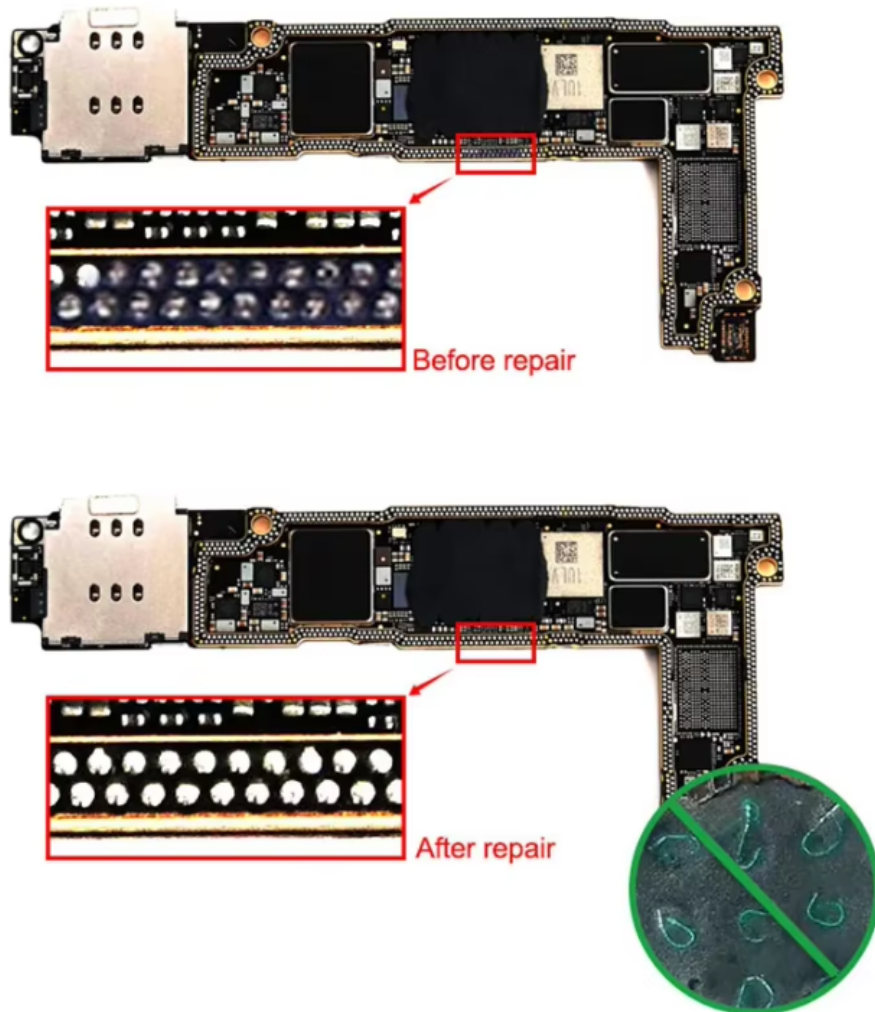
RL-007GA arkusz padów miedzianych do naprawy ścieżek RELIFE



Zestaw miedzianych punktów lutowniczych RELIFE RL-007GA to specjalistyczny arkusz przeznaczony do naprawy uszkodzonych lub zerwanych padów na płytkach drukowanych (PCB) oraz pod układami BGA. Arkusz zawiera precyzyjnie wycięte kształty i rozmiary ścieżek, co umożliwia bezmostkową, płynną rekonstrukcję punktów bezpośrednio na laminacie, eliminując konieczność prowadzenia klasycznych przewodów w newralgicznych miejscach. Proces aplikacji polega na odklejeniu wybranego elementu od warstwy nośnej i wlutowaniu go w docelowe pole, co znacząco zwiększa precyzję oraz stabilność połączeń w urządzeniach mobilnych.

Specyfikacja i parametry techniczne

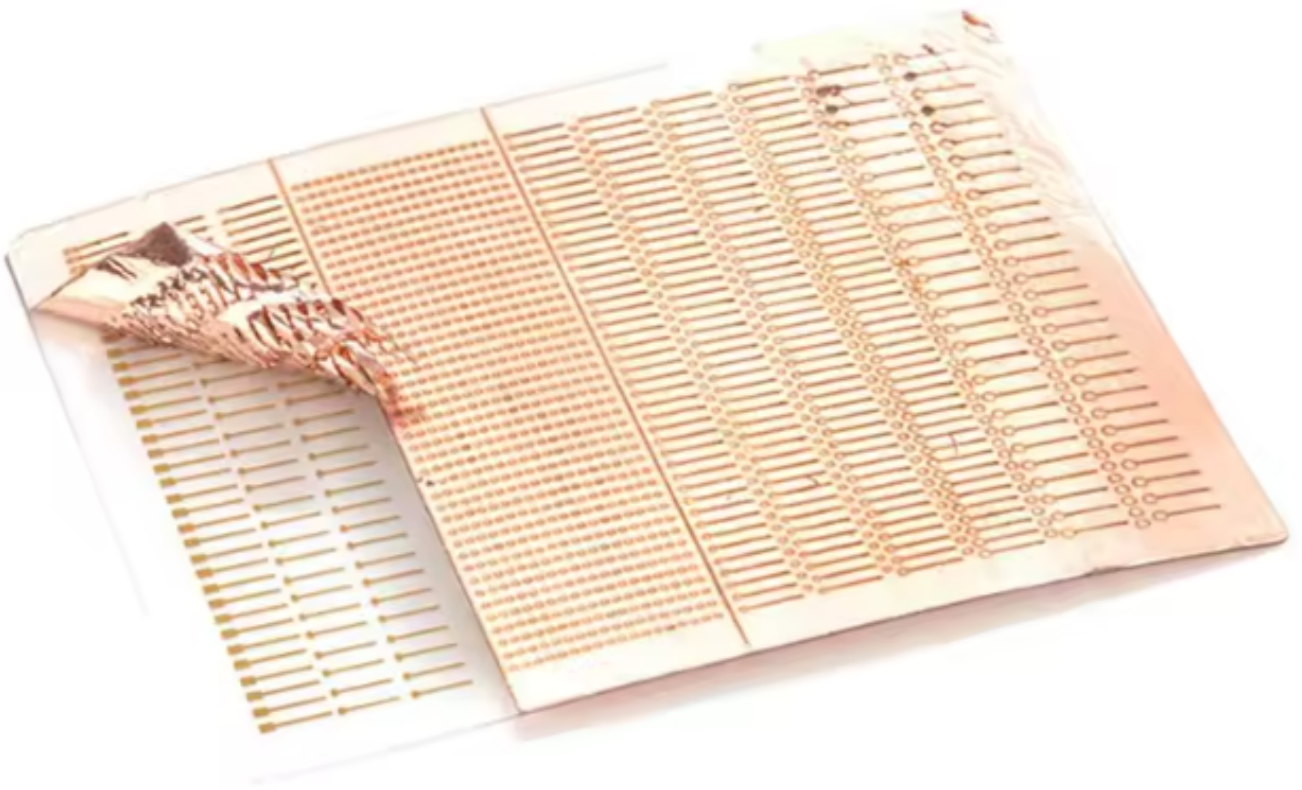
- Marka: RELIFE
- Model: RL-007GA
- Gotowe pady do naprawy ścieżek lutowniczych
- Zastosowanie: PCB, BGA
- Wymiary pojedynczego arkusza: 58 mm x 48 mm
- Dostępne kształty na arkuszu: kropki, proste ścieżki, ścieżki z oczkiem

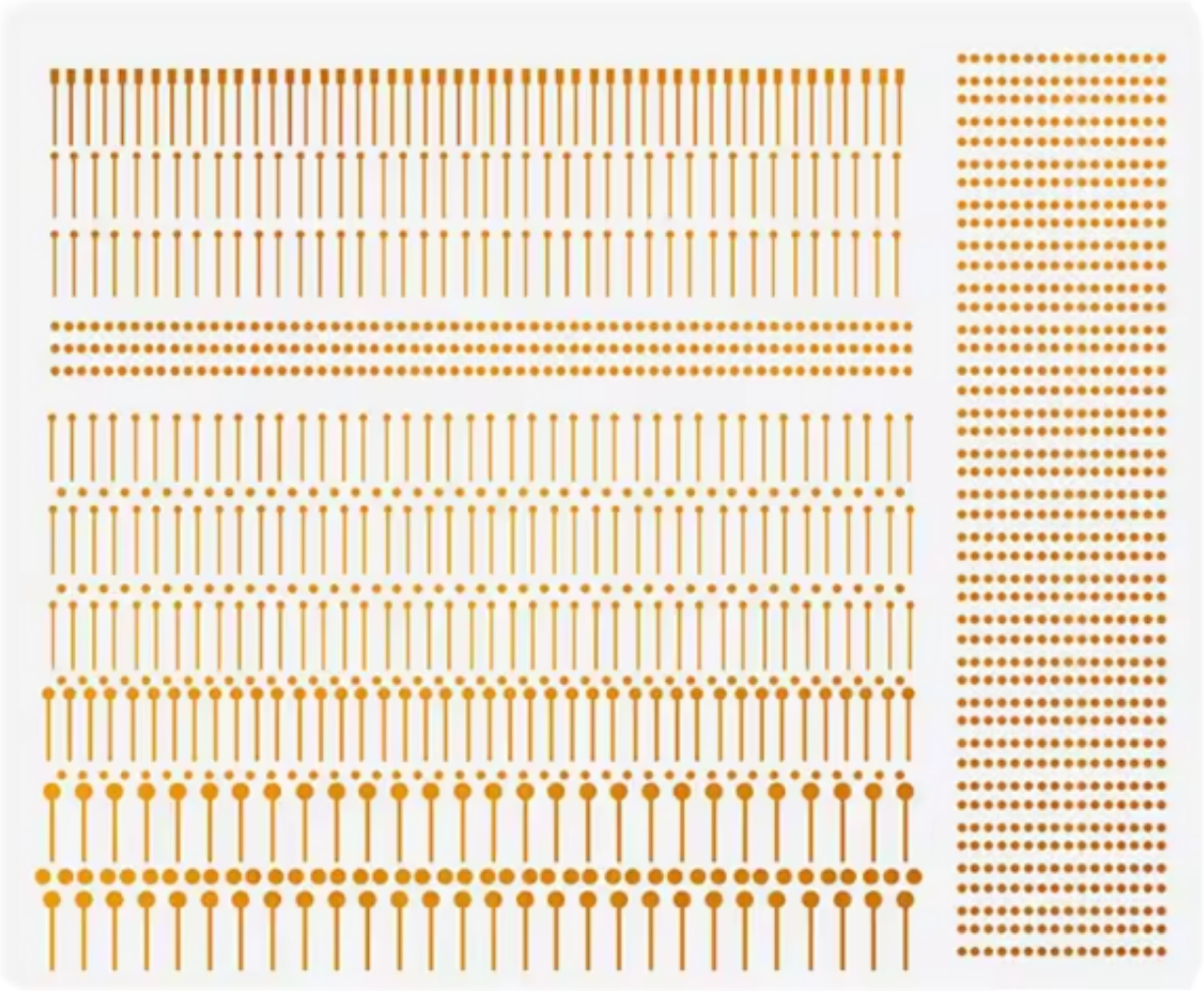


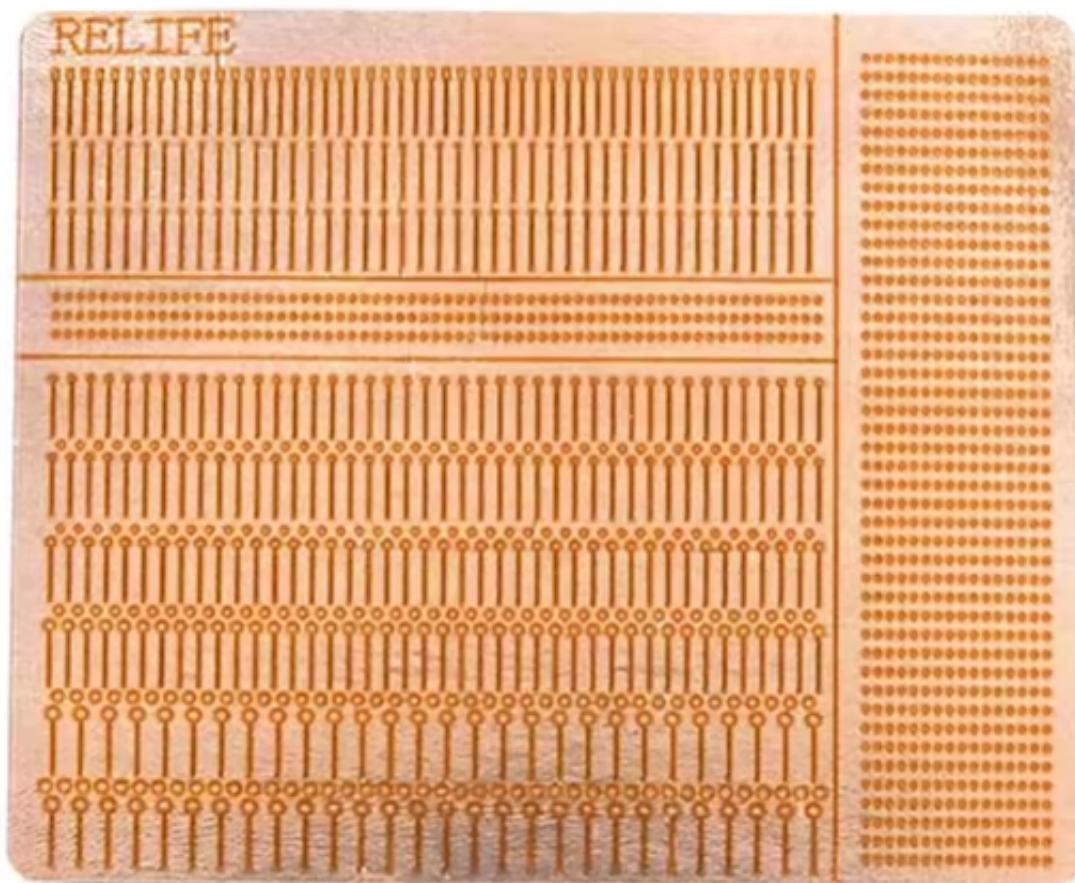
Zestaw zawiera

- 1 x Arkusz naprawczy padów RELIFE RL-007GA
- 1 x Oryginalne opakowanie ochronne









58mm

48mm